

杭州士兰微电子股份有限公司

关于举办“走进上市公司”活动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023 年 11 月 14 日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机构投资者对公司及行业的了解，增进公司市场认同和价值实现，提高公司质量。现将活动相关情况公告如下：

一、交流活动基本情况

1、时间：2023 年 11 月 14 日 14:00-15:30

2、地点：公司总部三楼大会议室

3、调研机构名称（排名不分先后）：中信证券、天风证券、杭银理财、南银理财、探骊基金、德亚投资、石锋资产、宽合基金、和信金创、上海泊通资管、上海聆泽投资、杭州优益增投资等 13 位机构投资者代表

4、公司接待人员：董事会秘书、财务总监陈越先生

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题 1：公司目前各条芯片生产线的产能利用率情况？

回复：目前公司 5 吋、6 吋芯片生产线产能利用率为 90%以上，且保持稳定；8 吋芯片生产线保持满负荷生产；12 吋芯片生产线由于产品结构调整加快，减少了低附加值产品的产出，产能利用率有所下降，后续随着 IGBT 等高附加值产品的上量，产能利用率将会显著回升，预计回到 90%以上。

问题 2：IGBT 产能爬坡节奏以及在汽车、光伏模块的最新出货情况？

回复：目前 12 吋芯片生产线的 IGBT 芯片产能约为 2.5 万片/月，产出约为 1.5 万片/月，我们计划到 2024 年第二季度、最晚第三季度可以实现满产。8 吋芯片生产线也有 1 万片/月的 IGBT 产能。IGBT 模块的上量一直在加快，三季度在更多的车厂开始上量，同时我们正在争取光伏市场更多的份额，预计明年会有更

好的市场表现。

问题 3：如何看待消费电子的复苏趋势？今年第四季度与明年的需求恢复节奏展望？

回复：消费电子总体在第四季度有一些温和的复苏迹象。公司将继续加强与细分领域的头部客户合作，积极开拓智能手机、可穿戴设备、笔电、家电等消费市场。

问题 4：12 吋芯片生产线设备折旧年限及产能建设与爬坡情况？

回复：公司 12 吋芯片生产线设备折旧年限一般为 8 年。厦门 12 吋产线计划在明年第二季度、最晚第三季度实现基本满产，进入正常发展阶段。杭州 12 吋产线已有部分设备到厂并投入生产，项目建设正在稳步推进中。厦门 12 吋产线因设备先进、自动化率高，今后将更多满足车规级、工规级芯片上量的需求。

问题 5：公司 MEMS 传感器业务最新进展情况，尤其是手机领域的产品进展？

回复：公司六轴惯性传感器（IMU）已在手机头部大厂验证通过，即将上量。公司 MEMS 传感器产品除在智能手机、可穿戴设备等消费领域继续加大供应外，正在加快向白电、工业、汽车等领域拓展。

问题 6：毛利率与研发费用投入展望？

回复：随着公司持续推出富有竞争力的产品，持续加大在大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场的推广力度，同时持续改善生产成本，我们预计今年 4 季度公司产品综合毛利率水平将企稳并逐步改善。公司将持续加大对模拟电路、功率器件、功率模块、MEMS 传感器、碳化硅 MOSFET 等新产品的研发投入，加快汽车级、工业级电路和器件芯片工艺平台的建设进度，加大汽车级功率模块和新能源功率模块的研发投入。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日